LAGENAUFBAU HDI (Standard)

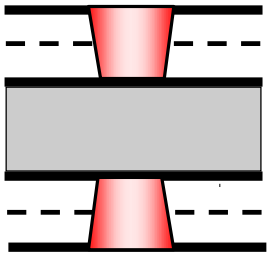
HDI04_1+2+1_1,40_35

4 - Lagen
Kern: 1,20 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.: | **1 + 2 + 1**

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	2			35 µm		33	
			1,200 mm			1200	
3	3			35 µm		33	
					1 x 1080	60	
4	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1410

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,40**	+/-	0,11	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	1,49	+/-	0,14	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,55	+/-	0,16	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
04.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.01.2006	R. Schönholz	00	Seite:	1+